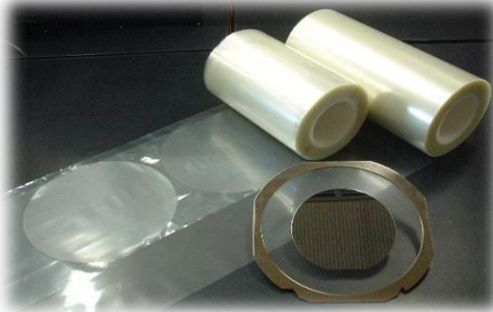


切割膠帶(晶圓/基板封裝)

UV Dicing Tape line-up (for Wafer/Package)

No.6360-00系列晶圓切割膠帶特徵

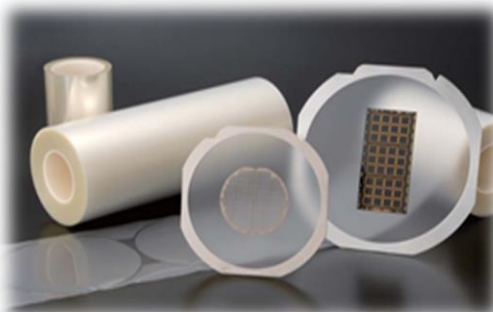
- 優越基材伸展性及等方性，進行擴張作業不必加熱
- 易剝離設計(降低晶片殘膠及損壞風險)
- 薄膠設計成功降低背崩發生率
- PO材質符合歐盟規定無鹵符合RoHS檢測



製品號碼	6360-00	6360-20	6360-50	6360-80	6362-20
類型	標準	高黏性	易撿晶	易撿晶 降低崩製	抗靜電

No.6360-15系列基板封裝切割膠帶特徵

- 優秀基材膠層設計，成功增加工件貼附性降低飛料機率
- 特殊基材設計降低製程毛邊、膠絲困擾
- UV固化易剝離設計下料取件容易
- PO材質符合歐盟規定無鹵符合RoHS檢測



製品號碼	6360-15	6360-25	6360-55	6360-95	6362-25
類型	標準	高黏性	易撿晶	高黏性 易撿晶	抗靜電

其他還有不同類型的切割膠帶可以供您選擇